

NEW

第45回 ネプコン ジャパン出展  
会期:2016/1/14(水)~16(木)  
東6ホール ブースNo.E52-32

■ セミコン 韓国出展  
会期:2016/1/27(水)~29(木)  
ソウル COEX  
Hall A ブースNo.2154

保護テープ貼付

ナイフエッジ防止加工

NCG付きBG

8インチ対応枚葉POL

自動スクラブ洗浄

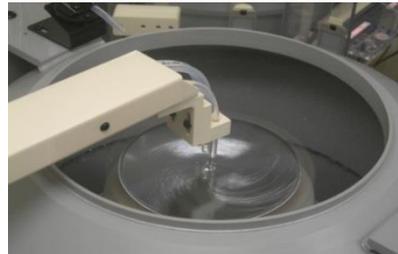
非接触テープ剥離

パターン付ウエハRCA洗浄

枚葉式研磨機



枚葉RCA洗浄



## 《SiC加工》(サファイア・GaN加工)

- ラップ研磨からグラインド研削へ
- 研削加工で加工時間, コストを低減

高剛力 **研削**

ファイン仕上げ表面粗さ  
 $Ra < 0.6 \sim 0.8nm$

ファイン仕上げ反り  
 $0.2 \sim 0.4mm$



- 前工程の加工ダメージ低減とCMP バッチ **研磨**
- 高速・超平滑面を得るCMP

SiCウエーハSi面CMP表面粗さ  
 $Ra < 0.1nm (1 \text{ \AA})$



- パーティクル, 金属汚染除去洗浄

RCA **洗浄**

- 清浄面に洗浄
- パーティクル

$T/M: \leq 10 \text{ 個/WF } (\geq 0.3\mu m)$

金属汚染

$B/M: < 5 \times 10^{10} \text{ atoms/cm}^2$

